

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2022年6月30日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]1300号）核准，公司2020年7月于北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行人民币普通股10,000,000股，发行价为48.47元/股，募集资金总额为人民币484,700,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币38,776,000.00元（含税），余额为人民币445,924,000.00元。

该次募集资金到账时间为2020年7月17日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月20日出具天职业字[2020]32804号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年6月30日止，本公司具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	利息收入净额	截至2022年6月 30日止余额
中国建设银行合肥青年路支行	34050145470800001828	-		2,249,588.57	73,937,007.27
中国银行股份有限公司重庆水土支行	111674531230	-		444,015.37	39,856,128.37
中国银行股份有限公司重庆水土支行	113074526840	-		443,053.84	27,808,801.41
东莞银行股份有限公司合肥分行	568000012900396	2021-12-16		7,171.70	
中国建设银行重庆两江分行	50050104360000002612	2021-12-17		723.87	
兴业银行合肥屯溪路支行	499030100100293125	2021-12-30	164,000,000.00	259,894.58	
华夏银行北京亦庄支行	10291000002316900	2022-1-26	141,924,000.00	1,919,104.99	
华夏银行合肥经济技术开发区支行	14756000000246035	2021-12-21	140,000,000.00	1,791,169.90	
中国建设银行股份有限公司郟都支行	51050159720800004091	注		402,381.67	
合计	——	——	<u>445,924,000.00</u>	<u>7,517,104.49</u>	<u>141,601,937.05</u>

注：银行账号为 51050159720800004091 的中国建设银行股份有限公司郫都支行系为全资子公司成都拓维高科光电科技有限公司投资项目有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（二期）项目设立，2021 年 4 月公司将原项目变更为“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”和“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”，该账户资金已全部转出，目前转为一般存款账户使用。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

前期募集资金使用情况详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第三届董事会 2021 年第八次会议及第三届监事会 2021 年第五次会议，于 2021 年 4 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司 2021 年 3 月 29 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《翰博高新材料（合肥）股份有限公司变更募集资金用途公告》及相关公告。

鉴于有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（一期）项目已进入全面量产阶段，该项目使用先进技术和设备，设备品质优良，产品良率高，产能利用率可大幅提升，满足现阶段市场需求。有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（二期）项目将根据市场情况进行建设。为应对日益变化的市场环境，公司拟投资“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”和“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”，公司通过建设背光模组生产线，将增强公司生产能力，完成 Mini-LED 灯板的布局，建设 LCM 组装线生产液晶显示模组拓展公司产业链，同时进行 AMOLED 掩膜版实验线等新工艺、新技术类型的研发，项目完成后，将构建先进、高效的生产体系和科学、完整的创新研发体系，提高企业的市场占有率和规模，能够有效的满足客户的需求，提升公司的实力。

基于上述原因，公司决定将原募集资金投资项目“有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（二期）项目”剩余的募集资金 14,000.00 万元用于本次新增募投项目“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”和“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”。截止 2022 年 6 月 30 日，重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目累计投入 4,058.79 万元，重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目累计投入 3,482.78 万元。

变更后项目资金使用情况见附件 1。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况说明

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，累计已使用募集资金 30,997.74 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 751.71 万元，由于募投项目均尚未完工，本公司尚未使用前次募集资金结余 14,160.19 万元，占前次募集资金总额的 29.21%，尚未使用资金将按计划投入募集资金项目。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

本公司不存在无法单独核算效益情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

募投项目尚在建设期，尚未达到能实现承诺收益的条件。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2020 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按向不特定合格投资者公开发行股票说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

2022年10月18日

附件 1

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 6 月 30 日

编制单位：翰博高新材料（合肥）股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：484,700,000.00						已累计使用募集资金总额：309,977,431.59				
募集资金净额：441,183,962.27						各年度使用募集资金总额： 2020年使用：159,838,165.66 2021年使用：82,964,549.61 2022年1-6月使用：67,174,716.32				
变更用途的募集资金总额：140,920,398.41										
变更用途的募集资金总额比例：29.07%										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
1	背光源智能制造及相关配套设施建设项目	背光源智能制造及相关配套设施建设项目	141,924,000.00	141,924,000.00	72,151,207.28	141,924,000.00	141,924,000.00	72,151,207.28	-69,772,792.72	2022-12-31

2	有机发光半导体(OLED)制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂(二期)项目	重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目	140,000,000.00	80,000,000.00	40,587,887.00	140,000,000.00	80,000,000.00	40,587,887.00	-39,412,113.00	2023-3-31
		重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目		60,920,398.41 (注)	34,827,804.00		60,920,398.41 (注)	34,827,804.00	-25,172,196.00	2022-12-31
3	补充流动资金	补充流动资金	159,259,962.27	159,259,962.27	162,410,533.31	159,259,962.27	159,259,962.27	162,410,533.31	3,150,571.04	
合计			441,183,962.27	442,104,360.68	309,977,431.59	441,183,962.27	442,104,360.68	309,977,431.59	-131,206,530.68	---

注：公司于2021年3月26日召开第三届董事会2021年第八次会议及第三届监事会2021年第五次会议，于2021年4月13日召开2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：截至2021年2月28日，本次涉及变更的募集资金总额为原“有机发光半导体(OLED)制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂(二期)项目”暂未使用的募集资金140,920,398.41元(其中本金140,000,000元，利息920,398.41元)。变更的资金拟用投资建设重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目、重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目。

附件 2

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2022 年 6 月 30 日

编制单位：翰博高新材料（合肥）股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 (年新增利润总额)	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020	2021	2022 年 1-6 月		
1	背光源智能制造及相关配套设施建设项目	不适用	9,914.43	/	建设期	建设期	不适用	不适用
2	重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目	不适用	3,758.68	/	建设期	建设期	不适用	不适用
3	重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目	不适用	不适用	/	/	/	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	/	/	/	不适用	不适用
合计		---	---	---	---	---	---	---

注 1：项目背光源智能制造及相关配套设施建设项目、重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目尚在建设中，暂未产生实际效益。